

Product Change Notice (PCN)

件名：RX63x 系グループ製品ワイヤ材変更のご案内

発行日：6/11/2025

出荷開始予定日：10/1/2025

改版履歴：初版

変更内容の説明：

対象製品：RX63x 系グループ G バージョン製品（動作周囲温度 $T_{opr} = -40$ to $+105^{\circ}C$ ）
(RX630/631/63N/63T/63X-LQFP48/64/100/144 ピン)

対象後工程拠点：Renesas Semiconductor (Beijing) Co., Ltd

変更内容：ワイヤ材を銅線 (Cu) に変更します。

対象製品リスト：

別紙 型名一覧を参照してください。

変更の理由：

安定した供給と、生産性の向上を目的としております。

外形、実装、機能、品質、信頼性への影響：

外形、実装、機能、品質、信頼性への影響はありません。

製品の識別方法：

製品のトレースコードから、弊社生産履歴データの照会が可能です。

信頼性データについて：

信頼性確認済です。添付の補足資料をご参照ください。

サンプル出荷予定日：10/1/2025

サンプルのご要求につきましては、8/29/2025 までに弊社営業、販売特約店までお問い合わせをお願い致します。

製品/材料の化学物質データ：

弊社営業、販売特約店までお問い合わせをお願い致します。

ご注意：

1. PCN をお客様にお渡しした後 30 日以内に受理の御連絡を頂けない場合は、変更内容を御承認頂いたものとみなして変更を実施させていただきます。
2. お客様が PCN を受理されて承認手続きのための条件が有る場合は、PCN をお客様にお渡しした後 90 日以内に御連絡をお願い致します。90 日以内に何の御連絡もない場合も御承認頂いたものとみなして変更を実施させていただきます。
3. 変更内容について御承認頂けない場合、最終注文数の御提示と御発注をお願い致します。

この通知に関するお問い合わせは、弊社営業、特約店までお願い致します。

別紙 型名一覧

NO.	型名	パッケージ外形	ピン数
1	R5F5630ADGFB#V0	LFQFP	144
2	R5F5630ADGFP#H0	LFQFP	100
3	R5F5630ADGFP#V0	LFQFP	100
4	R5F5630BDGFB#V0	LFQFP	144
5	R5F5630BDGFP#V0	LFQFP	100
6	R5F56316DGFB#V0	LFQFP	144
7	R5F56316DGFP#V0	LFQFP	100
8	R5F56316SGFB#V0	LFQFP	144
9	R5F56317DGFB#V0	LFQFP	144
10	R5F56317DGFP#V0	LFQFP	100
11	R5F56317SGFB#V0	LFQFP	144
12	R5F56318DGFB#H0	LFQFP	144
13	R5F56318DGFB#V0	LFQFP	144
14	R5F56318DGFP#H0	LFQFP	100
15	R5F56318DGFP#V0	LFQFP	100
16	R5F56318SGFB#V0	LFQFP	144
17	R5F5631ADGFB#V0	LFQFP	144
18	R5F5631ADGFP#V0	LFQFP	100
19	R5F5631BDGFB#V0	LFQFP	144
20	R5F5631BDGFP#V0	LFQFP	100
21	R5F5631DDGFB#V0	LFQFP	144
22	R5F5631DDGFP#V0	LFQFP	100
23	R5F5631EDGFB#V0	LFQFP	144
24	R5F5631EDGFP#V0	LFQFP	100
25	R5F5631FDGFB#V0	LFQFP	144
26	R5F5631FDGFP#V0	LFQFP	100
27	R5F5631GDGFB#V0	LFQFP	144
28	R5F5631GDGFP#V0	LFQFP	100
29	R5F5631JDGFB#V0	LFQFP	144
30	R5F5631JDGFP#V0	LFQFP	100
31	R5F5631KDGFB#V0	LFQFP	144
32	R5F5631KDGFP#V0	LFQFP	100
33	R5F5631MDGFL#V0	LFQFP	48
34	R5F5631MDGFM#70	LFQFP	64
35	R5F5631MDGFM#H0	LFQFP	64
36	R5F5631MDGFM#V0	LFQFP	64
37	R5F5631NDGFL#V0	LFQFP	48
38	R5F5631NDGFM#V0	LFQFP	64
39	R5F5631PDGFL#V0	LFQFP	48
40	R5F5631PDGFM#70	LFQFP	64
41	R5F5631PDGFM#H0	LFQFP	64
42	R5F5631PDGFM#V0	LFQFP	64
43	R5F5631WDGFB#V0	LFQFP	144
44	R5F5631WDGFP#V0	LFQFP	100
45	R5F5631YDGFB#V0	LFQFP	144
46	R5F5631YDGFP#H0	LFQFP	100
47	R5F5631YDGFP#V0	LFQFP	100
48	R5F563NADGFB#V0	LFQFP	144
49	R5F563NADGFP#V0	LFQFP	100
50	R5F563NBDGFB#V0	LFQFP	144
51	R5F563NBDGFP#V0	LFQFP	100
52	R5F563NDDGFB#V0	LFQFP	144
53	R5F563NDDGFP#V0	LFQFP	100
54	R5F563NEDGFB#V0	LFQFP	144
55	R5F563NEDGFP#V0	LFQFP	100
56	R5F563NFDGFB#H0	LFQFP	144
57	R5F563NFDGFB#V0	LFQFP	144
58	R5F563NFDGFP#V0	LFQFP	100
59	R5F563NFHGFB#V0	LFQFP	144

NO.	型名	パッケージ外形	ピン数
60	R5F563NFHGFP#V0	LFQFP	100
61	R5F563NKDGFB#V0	LFQFP	144
62	R5F563NKDGFP#V0	LFQFP	100
63	R5F563NWDGFB#V0	LFQFP	144
64	R5F563NWDGFP#V0	LFQFP	100
65	R5F563NWHGFB#V0	LFQFP	144
66	R5F563NWHGFP#V0	LFQFP	100
67	R5F563NYDGFB#V0	LFQFP	144
68	R5F563NYDGFP#H0	LFQFP	100
69	R5F563NYDGFP#V0	LFQFP	100
70	R5F563NYHGFB#V0	LFQFP	144
71	R5F563NYHGFP#V0	LFQFP	100
72	R5F563T4EGFL#V0	LFQFP	48
73	R5F563T4EGFL#X0	LFQFP	48
74	R5F563T4EGFM#V0	LFQFP	64
75	R5F563T4EGFM#X0	LFQFP	64
76	R5F563T5EGFL#V0	LFQFP	48
77	R5F563T5EGFL#X0	LFQFP	48
78	R5F563T5EGFM#V0	LFQFP	64
79	R5F563T5EGFM#X0	LFQFP	64
80	R5F563T6EGFL#V0	LFQFP	48
81	R5F563T6EGFL#X0	LFQFP	48
82	R5F563T6EGFM#H0	LFQFP	64
83	R5F563T6EGFM#V0	LFQFP	64
84	R5F563T6EGFM#X0	LFQFP	64
85	R5F563TBAGFB#V1	LFQFP	144
86	R5F563TBAGFP#V1	LFQFP	100
87	R5F563TBAGFP#X1	LFQFP	100
88	R5F563TBBGFB#V1	LFQFP	144
89	R5F563TBBGFP#H1	LFQFP	100
90	R5F563TBBGFP#V1	LFQFP	100
91	R5F563TCAGFB#V1	LFQFP	144
92	R5F563TCAGFP#V1	LFQFP	100
93	R5F563TCBGFB#V1	LFQFP	144
94	R5F563TCBGFP#V1	LFQFP	100
95	R5F563TEAGFB#V1	LFQFP	144
96	R5F563TEAGFP#V1	LFQFP	100
97	R5F563TEBGFB#H1	LFQFP	144
98	R5F563TEBGFB#V1	LFQFP	144
99	R5F563TEBGFP#H1	LFQFP	100
100	R5F563TEBGFP#V1	LFQFP	100

・補足資料

1. 変更部材の概要

項目		変更前	変更後	備考
組立、選別工程拠点		Renesas Semiconductor (Beijing) Co., Ltd		-
部材	ワイヤ	Auワイヤ	Cuワイヤ	-
	リードフレーム	-	変更なし	-
	ダイボンド	-	変更なし	-
	モールド樹脂 (レジン材)	-	変更なし	-
パッケージ	ダイパッド形状	-	変更なし	-
捺印	マーク印	-	変更なし	-

2.4 M変化点（組立工程部材変更・追加）

検証項目	検証結果	判定
製造装置 Machine	現行品と同じです。	○
製造方法 Method	現行品と同じです。	○
作業者 Man	現行品と同じです。	○
材料 Material	認定した材料のみを使用致します。 完成品においても現行品と同等な信頼性試験を実施しており 問題ない事を確認しております。	○

3. 信頼性試験結果

Test Items	Test Conditions	ResultsFailure/Size
High Temperature Operating Life(HTOL)	Ta=125 °C, Vccmax, 1000 hrs	0/22
High Temperature Storage Life(HTSL)	Ta=150 °C, 1000 hrs	0/22
Temperature Humidity bias(THB) (*1)	Ta=85 °C, RH=85 %, Vccmax, 1000 hrs	0/22
Temperature Cycling(TC) (*1)	Ta=-65 °C to 150 °C , 300 cycles	0/22
Latch-Up(LU)	Pulse Current Injection, I=+/-150 mA	0/3
Electrostatic discharge(ESD-HBM)	1.5 kΩ, 100 pF, +/-2000 V, 1 time	0/3
Electrostatic discharge(ESD-CDM)	+/-1000V,1time	0/3
Solderability(SD)	245 °C, 5 s, Solder coverage ≥95 %	0/5
Resistance to Soldering Heat(PC)	MSL3(Moisture Sensitivity Level 3)	0/22

* 1) THB,TCはMSL3の前処理を実施しています。

・すべてのサンプルについて、製品仕様を満足することを確認するために電気的テストを行っています。

注：部材変更前と同じ評価項目で満足している事を確認しています。